

Материнская плата ASRock B760M PRO RS/D4, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5333
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	128

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	2
PCI-Ex1	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество M.2 сокетов	2
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	4
Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
USB 3.2 Gen1 внутр.	3
USB 2.0 внутр.	4

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC897
Количество каналов аудио	7.1

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	6

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	4
USB 2.0	2
Количество разъемов Type A (всего)	5
Количество разъемов Type C	1
PS/2	1
Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
RJ45	1
Максимальная скорость передачи, Мб/с	2500
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
HDMI	1
DisplayPort	1

Прочие характеристики

BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	244
Глубина, мм	244
Особенности	Слот M.2 2230 E-key для беспроводного модуля (опция)
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, инструкция, заглушка панели I/O, комплект кабелей, крепежный комплект
Ссылка на описание	https://www.asrock.com/mb/Intel/B760M%20Pro%20RSD4/index.asp#Specification